19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-110437

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)5月28日

H 01 L 21/56 21/66 7738-5F 7166-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

の発明の名称

樹脂封止パツケージの開封方法

②特 顧 昭59-231824

22出 願昭59(1984)11月2日

79発明者 西川

嘉 一 門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

⑩出 顋 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

砂代 理 人 弁理士 竹元 敏丸 外2名

明 細書

1 発明の名称

樹脂封止パッケージの開封方法

- 2 特許請求の範囲
- (1) 樹脂封止パッケージを、リードフレーム切り種し部が露出するまで強酸で処理後、該露出部を弗化樹脂で保護してから全体をチップがオープンするまで再度強酸で処理することを特徴とする機能封止パッケージの開封方法。
- 3 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は電気部品や電子部品を封止した樹脂封止パッケージの開封方法に関するものである。

(背景技術)

近年、電気、電子機器の部品の低コスト化と生産性向上のため、プラスチックによる封止がなされるようになってきた。 これらの電気部品や電子部品には例えばトランジスタ、ダイオード、コンデンサー、フイルター、整流器、抵抗体、コイルなどがあり、最近は高集費化、ハイパワー化の要

(発明の目的)

本発明の目的とするところは、樹脂封止パッケージとしての電気的特性及びチップ表面の観察チェェックができる樹脂封止パッケージの開封方法を提供することにある。

(発明の開示)

本発明は樹脂封止パッケージをリードフレーム 切り離し部が露出するまで強酸で処理後、該露出 部を弗化樹脂で保護してから全体をチップがオー

っクすることができたが従来方法で開封された開 対品についてはチップ表面の観察をチェックする ことはできたが電気的特性をチェックすることは できず、本発明の方法の優れていることを確認し た。

第 1 表

	実 施 例	従来例
電気的性能のチェック	可	不可
チップ表面のチェック	म्	可
パッケージピンの半田付	不 要	必要
発 煙 硝 酸 使 用 量	少	3

用成形品に樹脂封止パッケージの露出したリードフレーム切り離し部をはめ込んで保護することが 取扱い易く望ましいことである。以下本発明を実 施例に基づいて説明する。

(実施例)

エボキシ樹脂成形材料で樹脂対止したSOPパッケージを、リードフレーム切り離し部が露出するまで発煙硝酸で値かに容解処理後、該露出部を予じめパッケージに合わせて作成しておいた四弗化エチレン樹脂成形品にはめ込んで保護してから全体をチップがオープンするまで再度発煙硝酸に溶解処理した。

(従来例)

実施例と同じパッケージのピン部分を半田付し てから発煙硝酸で全体の樹脂を溶解除去した。

(発明の効果)

実施例及び従来例のパッケージ開封品を比較した結果は、第1表で明白なように本発明の方法で開封された開封品については樹脂封止パッケージとしての電気的特性及びチップ表面の観察をチェ